SAMPE JAPAN 会員各位殿

SAMPE Japan コンポジット委員会

委員長　田那村武司

コンポジット委員会　第73回研究会のご案内

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今回の研究会は、恒例になっております自動車用途コンポジットシンポジウムとして開催いたします。皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。

敬具

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

第13回　自動車用途コンポジットシンポジウム

**主催** SAMPE　Japan・コンポジット委員会，日本材料学会・複合材料部門委員会，同志社大学・先端複合材料研究センター

**開催日** 2021年11月12日(金)　10:00～16:45

**会場** online Microsoft Teams を利用する予定です．参加申込者には詳細をご連絡いたします．

**参加費** 一般： 10,000円（非課税）

共催・協賛会員： 5,000円（非課税）

ポスター発表学生： 無料

その他の学生： 3,000円（非課税）

お支払方法：　paypalによる支払を予定　参加申込者には詳細をご連絡いたします．

**<プログラム>**

**詳細は，同志社大学・先端複合材料研究センターのHPをご覧下さい．**

**http://rdccm.doshisha.ac.jp**

**開会挨拶 （10:00～10:05）** シンポジウム実行委員長 田中和人(同志社大)

**<ポスターセッション1:　ショートオーラル・セッション>　（10:05～11:15）**

[ 17篇，ホームページ　http://rdccm.doshisha.ac.jp　に掲載]

**<ポスターセッション2：　ディスカッション>　（11:15～11:50）**

**<一般講演> （11:50～12:30）**

GS-1 射出オーバーモールドにおける接合部の樹脂温度・圧力が接合強度に与える影響

〇松本紘宜 (神奈川大学), 竹村兼一

GS-2 一方向ジュート麻スライバー強化グリーンコンポジットの強度及び疲労特性

〇加藤木秀章 (実践女大)，恒川弥子

**<昼食休憩>　（12:30～13:30）**

**<基調講演> （13:30～15:30）**

K-1 自動車軽量化に向けたCFRP生産課題と技術開発

水谷　篤　氏　(日産自動車株式会社)

K-2 CSCNTの研究開発とその社会実装

柳澤　隆　氏　(株式会社GSIクレオス)

**<休憩>　（15:30～15:40）**

**<基調講演> （15:40～16:40）**

K-3 自動車部品における複合材料の活用拡大

北野　一朗　氏　(帝人株式会社)

**閉会挨拶 （16:40～16:45）** 　　　　　　 先端複合材料研究センター副センター長　　　　大窪 和也（同志社大）

**＜各種締め切り＞**

・シンポジウム参加申込締め切り： 2021年11月4日（木）

**＜各種問い合わせ先＞**

同志社大学・先端複合材料研究センター ：rdccm@mail.doshisha.ac.jp

あるいは実行委員長　田中和人 ：ktanaka@mail.doshisha.ac.jp

まで，ご連絡下さい．

**お申し込み方法：E-mailにて下記の内容をご送付下さい．**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**第13回　自動車用途コンポジットシンポジウム　参加申込書**

**同志社大学・先端複合材料研究センター事務局　行**

**E-mail: rdccm@mail.doshisha.ac.jp**

**シンポジウム参加申込締め切り：2021年11月4日（木）**

**氏名（ふりがな）：**

**住所：**

**所属機関：**

**部署：**

**電話番号：**

**E-mail アドレス：**

**所属学協会，会員資格：**

**参加費：一般：10,000円，共催・協賛会員：5,000円，ポスター発表学生：無料，その他の学生：3,000円　　（該当するもの以外を削除してください）**